2014年3月7日

稳懋公告2013年第四季及2013全年财务报告

- **本季合并营收新台币19.26亿元，较前季减少24%**
- **本季合并毛利率为26.6%，较前季减少3.4个百分点**
- **本季合并营业净利为新台币2.44亿元，较前季减少50%**
- **本季合并税后净利为新台币1.26亿元，合并税后每股盈余新台币0.17元**
- **2013年合并全年营收达新台币104.81亿元，合并税后每股盈余新台币2.40元**

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(7)日公告 2013 年第四季财务报告。本季合并营收为新台币 19.26 亿元，较前季减少 24%，较去年同期减少 32%。

2013 年第四季合并营业毛利为新台币 5.13 亿元，较 2012 年第四季减少 48%，较前季减少 32%。2013 年第四季合并毛利率为 26.6%，较前季减少 3.4 个百分点，主要为产能利用率下滑所致。

2013 年第四季合并营业利益为新台币 2.44 亿元，较 2012 年第四季减少 64%。2013 年第四季合并税后每股盈余新台币 0.17 元。

2013 年全年合并营收达新台币 104.81 亿元，较 2012 年减少 7%。合并营业毛利为新台币 32.32 亿元，较 2012 年减少 11%。合并营业净利为新台币 21.10 亿元，较 2012 年减少 14%。合并税后每股盈余新台币 2.40 元，2012 年为新台币 2.31 元。

稳懋半导体总经理王郁琦指出：2013 年是充满挑战的一年，稳懋除持续致力于领先同业的成本结构改善，且有信心凭借本公司具策略性的研发实力，将进一步强化稳懋于全球砷化镓晶圆代工服务之地位。

回顾 2013 年暨展望 2014 年

2013 年产业变化对本公司之影响：

- 2013 上半年因预期高阶智能型手机将有高成长，导致 2013 年下半年产业链进入库存调整。虽然中低阶智能型手机有高度成长，但本公司客户因布局较少而并未受惠。

- 2013 年应用于手机及 WiFi 射频开关(Switch)的砷化镓 pHEMT 制程逐渐受到硅制程取代，也导致本公司这部分营收下滑。在高整合度的需求之下，此趋势在 2013 年下半年特别明显。
- 手机制造商采用多模多频 (Multi-mode, Multi-band) 功率放大器模块的速度，高于本公司预期。
- 缩小尺寸的组件设计发展，成为满足高阶智能型手机所需之趋势，另外在产业面临库存调整的阶段也加深功率放大器(PA)的价格压力。

虽然上述的不利因素影响本公司 2013 年的获利，亦可能持续影响 2014 年的营运，但影响程度将明显缩小。本公司仍对长期营收成长持乐观看法。

- 本公司预期 2014 年产业将回归到传统的淡旺季趋势，这是因为射频开关(Switch)所受硅制程取代的影响、组件尺寸的缩小以及价格竞争的冲击都将明显减缓。此外，我们相信产业需求将随着 4G LTE 手机渗透率而提升。
- 本公司对于非手机相关应用之高毛利产品的发展深具信心，我们预期此类产品的营收比例可望在未来的 3 到 5 年由现在的 10%提升到 20%。其中特别是应用于 4G LTE 基地台的氮化镓(GaN) HEMT 制程，将可解决传统硅制程所无法克服的高功率传输的需求。
- 本公司长期服务亚洲手机相关客户，并对于此市场的进展特别关注，许多亚洲客户的市占率都有提升的趋势，尤其是大中华地区。
- 本公司相信整合组件大厂产能外包的趋势将持续，并且稳懋的竞争力将随着完整的制程技术蓝图及持续加强的制造能力而进一步提升。
- 随着消费者对于数据传输量的持续增加，驱动了移动运算的趋势大幅迈进，也随着移动数据的需求成长，同时带动了对微型化及低耗电芯片的需求，这些都需更进一步仰赖砷化镓的绝佳特性。
- 随着 4G LTE 崛起，单一手机频段增加对砷化镓的需求将持续成长。
- 其他长期影响砷化镓需求的正面因素还有 LTE-A 载波聚合技术及物联网(IoT)的发展。
- 展望下一世代的 5G 技术，其数据传输速度将是现行 4G LTE 的 100 倍，目前只有砷化镓功率放大器可以应付如此快速的数据传输，也会更进一步拉大砷化镓与硅制程功率放大器之间性价比的差距。

关于稳懋半导体

稳懋半导体是领先全球的专业砷化镓晶圆代工服务公司。稳懋拥有超过 14 年的砷化镓晶圆代工经验，总部位于林口华亚科技园区，现有超过 1,400 名员工，并通过 ISO9001/14001 认证。稳懋拥有完整的技术团队，在微波无线宽带通讯领域中，提供全面的制程技术蓝图及制造能力。稳懋产品线可满足 50 MHz 至 100GHz 内各种不同频带无线传输系统的应用，包含智能型手机、行动通讯基础设施、光纤通讯、有线电视(CATV)及车用市场等领域。